

澜起科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：澜起科技

证券代码：688008

编号：2026-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>AceCamp International Limited Aj asset management American Century Investments Ankaa Capital Limited Baron Capital Capital Dynamics Fidelity International Holdings Limited Fullerton Fund Management GF Securities (HK) Harvest fund IGWT Investment Janchor Partners Oberweis Asset Management (Hong Kong) Limited Open Door Capital Point 72 Uni-President Asset Management 广发基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 兴证全球基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 永赢基金管理有限公司</p>

交银施罗德基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司
创金合信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
同泰基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司
金元顺安基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
诺德基金管理有限公司
中银基金管理有限公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
平安基金管理有限公司
长安基金管理有限公司
东方阿尔法基金管理有限公司
汇丰晋信基金管理有限公司
中邮创业基金管理股份有限公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
华泰保兴基金管理有限公司
富荣基金管理有限公司
百嘉基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
尚正基金管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
九泰基金管理有限公司

财通基金管理有限公司
方正富邦基金管理有限公司
太平基金管理有限公司
中国人寿资产管理有限公司
华泰资产管理有限公司
中信保诚资产管理有限责任公司
国华兴益保险资产管理有限公司
华安财保资产管理有限责任公司
百年保险资产管理有限责任公司
华夏人寿保险股份有限公司
合众资产管理股份有限公司
昆仑健康保险股份有限公司
平安银行股份有限公司
广发证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
东方证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
长城证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
华创证券有限责任公司
中原证券股份有限公司
华金证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
华福证券股份有限公司
国信证券股份有限公司

西部证券股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司
国投证券股份有限公司
第一上海证券有限公司
东海证券股份有限公司
山西证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
华源证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
国海证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
开源证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
湘财证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
财通证券股份有限公司
华安证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
汇丰前海证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
野村东方国际证券有限公司
摩根大通证券(中国)有限公司
东亚前海证券有限责任公司
东方财富证券股份有限公司
广发证券资产管理(广东)有限公司

财通证券资产管理有限公司
华宝信托有限责任公司
安徽弘开投资管理有限公司
北京秋收私募基金管理有限公司
北京时代复兴投资管理有限公司
北京鑫翰资本管理有限公司
北京泽铭投资有限公司
北京致顺投资管理有限公司
晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司
福泽源(上海)私募基金管理有限公司
福州开发区三鑫资产管理有限公司
广东正圆私募基金管理有限公司
海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙)
杭州玖龙资产管理有限公司
禾永投资管理(北京)有限公司
河北省国企改革基金管理有限公司
鸿运私募基金管理(海南)有限公司
湖南正兴私募基金管理有限公司
华杉瑞联基金管理有限公司
江西彼得明奇私募基金管理有限公司
曼林(山东)私募(投资)基金管理有限公司
南京璟恒投资管理有限公司
宁波宝隽资产管理有限公司
宁波量利私募基金管理有限公司
宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
青岛素本投资管理有限公司
青骊投资管理(上海)有限公司
瑞圣源(上海)私募基金管理有限公司
厦门市融开资产管理有限公司

上海彬元资产管理有限公司
上海博笃投资管理有限公司
上海常春藤私募基金管理有限公司
上海泮杨资产管理有限公司
上海亘曦私募基金管理有限公司
上海国理投资有限公司
上海瀚伦私募基金管理有限公司
上海竝观资产管理有限公司
上海嘉世私募基金管理有限公司
上海金恩投资有限公司
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)
上海雷钧资产管理有限公司
上海理臻投资管理有限公司
上海聆泽私募基金管理有限公司
上海茂典资产管理有限公司
上海摩旗投资管理有限公司
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
上海清淙投资管理有限公司
上海睿郡资产管理有限公司
上海森锦投资管理有限公司
上海盛宇股权投资基金管理有限公司
上海万丰友方投资管理有限公司
上海汐泰投资管理有限公司
上海孝庸私募基金管理有限公司
上海亚商股权投资管理有限公司
上海益昶资产管理有限公司
上海赢仕投资管理有限公司
上海佑诗私募基金管理有限公司
上海云门投资管理有限公司

<p>上海匀升投资管理有限公司</p> <p>上海兆顺私募基金管理有限公司</p> <p>上海中域资产管理中心(有限合伙)</p> <p>上海重阳投资管理股份有限公司</p> <p>深圳抱朴资产管理有限公司</p> <p>深圳大道至诚投资管理合伙企业(有限合伙)</p> <p>深圳宏鼎财富管理有限公司</p> <p>深圳前海旭鑫资产管理有限公司</p> <p>深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司</p> <p>深圳市恒泽私募证券投资基金管理有限公司</p> <p>深圳市兰权资本管理有限公司</p> <p>深圳市珞瑜私募证券投资基金管理有限公司</p> <p>深圳市尚诚资产管理有限责任公司</p> <p>深圳中天汇富基金管理有限公司</p> <p>苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)</p> <p>西安敦成私募基金管理有限公司</p> <p>西安瀑布资产管理有限公司</p> <p>西咸新区旷特投资管理有限公司</p> <p>循远资产管理(上海)有限公司</p> <p>涌德瑞烜(上海)私募基金管理有限公司</p> <p>远信(珠海)私募基金管理有限公司</p> <p>张家港高竹私募基金管理有限公司</p> <p>中盛晨嘉(深圳)私募证券投资基金管理有限公司</p> <p>资衡(上海)商业管理有限公司</p> <p>野村投资管理香港有限公司</p> <p>苏州景千投资管理有限公司</p> <p>世嘉控股集团(杭州)有限公司</p> <p>深圳拓森投资控股有限公司</p> <p>深圳猎投资本合伙企业(有限合伙)</p>

深圳丞毅投资有限公司
上海拓聚投资管理有限公司
上海世亨私募基金管理有限公司
上海三星半导体有限公司
上海隆象私募基金管理有限公司
上海度势投资有限公司
上海德汇集团有限公司
上海道仁资产管理有限公司
南京天奥投资管理有限公司
杭州红骅投资管理有限公司
硅谷天堂产业集团股份有限公司
广东恒健国际投资有限公司
大和日华(上海)企业咨询有限公司
常州投资集团有限公司
常州金融投资集团有限公司
北京恒诚拓新科技有限公司
艾希控股有限公司
中国国际金融香港资产管理有限公司
中信证券国际有限公司
山河资本管理香港咨询有限公司
源峰基金管理有限公司
瑞银资产管理瑞士股份公司
保银资产管理有限公司
宏利投资管理(香港)有限公司
安本私募基金管理(上海)有限公司
鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司
卓汇投资(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
中投国际(香港)有限公司

	<p>粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙)</p> <p>野村证券投资信托股份有限公司</p> <p>新加坡利安资金管理公司</p> <p>香港瑞华投资管理有限公司</p> <p>天风国际证券集团有限公司</p> <p>施罗德国际金融集团有限公司</p> <p>摩根士丹利资本国际公司</p> <p>摩根士丹利亚洲有限公司</p> <p>美银证券</p> <p>麦格理集团有限公司</p> <p>凯基证券亚洲有限公司</p> <p>静远投资管理有限公司</p> <p>交银国际控股有限公司</p> <p>嘉恒投资股份有限公司</p> <p>花旗環球金融亞洲有限公司</p> <p>弘鼎资本有限公司</p> <p>恒安标准人寿(亚洲)有限公司</p> <p>浩成资产管理有限公司</p> <p>韩国未来资产集团</p> <p>海通国际研究有限公司</p> <p>高盛(亚洲)有限责任公司</p> <p>恩宝资产管理有限公司</p> <p>东洋证券亚洲有限公司</p> <p>彩石资本有限公司</p>
时间	2026年3月31日至4月2日
地点	公司会议室，部分通过电话会议形式接待调研
出席人员	公司执行董事兼总经理Stephen Tai先生、副总经理兼财务负责人苏琳女士参加部分会议，董事会秘书傅晓女士参加全部会议。

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司介绍了2025年度业绩情况及2026年经营计划</p> <p>（一）2025年度业绩情况</p> <p>2025年，受益于AI产业趋势，行业需求旺盛，我们的互连类芯片出货量显著增加，推动公司2025年度经营业绩较上年度实现大幅增长，多项财务指标再创历史新高。</p> <p>1.经营业绩大幅增长，发展质量持续提升</p> <p>2025年度，公司实现营业收入54.56亿元，较上年度增长49.9%；互连类芯片产品线实现销售收入51.39亿元，较上年度增长53.4%；实现归属于母公司股东的净利润22.36亿元，较上年度增长58.4%；2025年度，公司股份支付费用为4.31亿元，剔除股份支付费用影响后的归属于母公司股东的净利润为26.47亿元，较上年度增长81.0%。经营活动产生的现金流量净额为20.22亿元，连续四年增长，彰显公司稳健的经营质量。</p> <p>2025年度，公司产品竞争力持续提升，公司盈利能力也进一步增强，具体体现在公司毛利率和净利率上。2025年，公司整体毛利率为62.2%，较上年度提升4.1个百分点；互连类芯片毛利率达到了65.6%，较上年度提升2.9个百分点，其中第四季度毛利率达到了67.8%，环比提升2.1个百分点。2025年公司的净利润率为41.0%，较上年度提升2.2个百分点。</p> <p>2025年度，公司的营业收入、互连类芯片销售收入、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额均创公司年度历史新高。</p> <p>报告期末，公司总资产为137.5亿元，净资产为129.2亿元。</p> <p>2.DDR5 快速渗透及新品逐步应用，保持内存互连领域领先地位</p> <p>2025年全球AI产业快速发展，带动服务器市场需求持续高涨，DDR5在下游的渗透率快速提升，内部子代持续迭代。我们精准把握DDR5迭代升级与AI驱动的产业机遇，持续推进产品创新与升级。我们的DDR5 RCD芯片出货量在报告期内大幅增长。在DDR5内部子代迭代进程中，我们的第三子代RCD芯片规模出货，同时已量产支持7200MT/s速率的第四子代RCD芯片。2025年下半年，我们的DDR5第三子代RCD芯片销售收入已超过第二子代产品，在新子代产品的商业化进程方面行业领先。我们作为内存互连芯片行业的领跑者和DDR5 RCD芯片国际标准的牵头制定者，在DDR5世代的竞争中持续保持全球领先地位。</p> <p>同时，我们引领DDR接口技术创新，加速内存互连新品商业化落地，</p>
----------------------	--

MRCDD/MDB芯片以及CKD芯片在报告期内持续迭代升级，并实现规模应用。

我们作为全球唯二可以提供DDR5第一子代MRCDD/MDB芯片的供应商，于2025年1月推出了第二子代产品，支持速率提升至12800MT/s，较第一子代产品提升45%。从2025年第四季度开始，我们的第二子代MRCDD/MDB芯片出货量显著提升，并凭借优异的性能和出色的稳定性获得客户认可，为后续产业规模放量奠定了基础。

我们继2024年在业界率先试产DDR5 CKD芯片（支持速率为7200MT/s）之后，于报告期内推出新一代CKD芯片，支持速率高达9200MT/s，可为下一代高性能PC提供关键技术支持。2025年CKD芯片的行业渗透率进一步提升，我们的产品出货量快速增长。

3.依托扎实技术积累拓展产品矩阵，提升 PCIe/CXL 互连领域综合竞争力

报告期内，我们持续深化市场拓展，凭借领先的技术实力及优异的产品性能，我们的PCIe Retimer芯片呈现良好成长态势。作为全球主要供货PCIe 5.0 Retimer芯片的两家厂商之一，我们自主研发的SerDes技术为产品的持续迭代提供了坚实支撑。2025年1月，我们推出PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片并向客户送样，2026年1月，我们发布了PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解决方案。目前我们正在积极推进PCIe 7.0 Retimer芯片的研发。展望未来，随着AI服务器需求持续增长以及PCIe协议传输速率的不断提升，PCIe Retimer芯片的重要性愈发凸显，其应用场景也将进一步拓展，推动市场规模持续扩大。

在成功自研SerDes技术并实现PCIe Retimer芯片产业化的过程中，我们已积累了深厚的SerDes技术储备与广泛的客户资源，为布局PCIe Switch芯片奠定了坚实的基础。报告期内，我们正在稳步推进PCIe Switch芯片工程研发。

报告期内，我们与合作伙伴持续推进CXL技术的商用化进程，已有更多服务器厂商推出基于澜起MXC芯片的CXL内存扩展方案，CXL相关生态正逐步走向成熟。2025年1月，我们的MXC芯片成功入选CXL联盟公布的首批CXL 2.0合规供应商清单，同期入选的内存厂商三星电子和SK海力士，其受测产品均采用了我们的MXC芯片，2025年9月，我们推出基于CXL 3.1标准的MXC芯片，并开始向主要客户送样测试。CXL技术作为行业前沿技术，目前正处于蓬勃发展初期。展望未来，随着CXL生态的不断成熟和技术的广泛普及，MXC芯片市场将迎来广阔的发展空间。

4.坚持创新驱动发展，持续强化研发投入与技术实力

作为科技创新型企业，我们始终坚持创新驱动发展，持续加大研发投入，以增强公司的核心竞争力。2025 年度，我们的研发费用为 9.15 亿元，同比增长 19.9%，占营业收入的比例为 16.8%。我们的研发费用自 2019 年 A 股上市以来逐年增加。我们的研发技术团队具备国际化视野和卓越的专业能力，截至 2025 年末，公司研发技术人员为 583 人，占总人数的比例约为 74.4%，其中，具有硕士及以上学历的研发技术人员占比约 64%。

报告期内，我们取得的研发成果如下：

(1) 互连类芯片产品线：①内存互连芯片：DDR5 第四子代 RCD 芯片成功量产，完成 DDR5 第五子代 RCD 芯片、第二子代 MRCD/MDB 芯片、新一代 CKD 芯片量产版本的研发。②PCIe 互连芯片：推进 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片量产版本的研发，并将其应用于 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 解决方案，同时积极开展 PCIe 7.0 Retimer 芯片及 PCIe Switch 芯片的工程研发。③CXL 互连芯片：完成 CXL 2.0 MXC 芯片量产版本的研发，完成 CXL 3.x MXC 芯片的工程研发。④时钟芯片：完成首批时钟缓冲芯片（Clock Buffer）及展频振荡器的工程研发。

(2) 津逮®产品线：发布第六代津逮®性能核 CPU。

(3) 在知识产权领域，我们新申请 40 项发明专利，共获得 36 项授权发明专利；新提交 19 项集成电路布图设计登记申请，共获得 24 项布图登记证书。截至 2025 年末，我们累计获授权发明专利 224 项、实用新型专利 1 项、集成电路布图设计登记证书 103 项以及计算机软件著作权登记证书 13 项。

5.构建长效回报机制，与股东共享发展成果

我们始终秉持“以投资者为本”的发展理念，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，致力于构建长效回报机制，与股东分享企业的成长与发展成果。报告期内，我们实施了2024年度及2025年中期利润分配方案，合计派发现金股利约6.70亿元；2025年度我们的分红预案为每10股派发现金红利人民币3.90元（含税），预计将派发现金股利4.72亿元。除现金分红之外，在报告期内我们还推出两期股份回购计划，其中第一期回购股份用途为员工持股计划/股权激励，该计划已实施完毕，回购金额为2.00亿元；第二期回购股份用途为减少公司注册资本，回购计划的资金总额为2-4亿元，截至2025年末公司已回购2.20亿元。自2019年7月A股上市以来至2025年末，我们累计派发现金红利23.67亿元，累计回购股份金额为14.30亿元。

6.深化国际化战略布局，成功实现 H 股上市

2026年2月，公司于香港联交所主板正式挂牌上市（股票代码：6809.HK），

搭建起A+H股双资本平台，为公司全球化布局与长期可持续发展奠定坚实基础。本次公司H股全球发售获得国际投资者积极认购：在基石投资者方面，我们引入了多家顶级国际长线机构、战略投资人及知名科技专项基金，基石认购比例占公司H股基础发行规模的50%；在锚定投资者方面，我们收到的国际配售订单数量超过500条，订单金额超300亿美元，覆盖倍数超过锚定投资者实际获配金额的60倍，充分体现了全球资本市场对公司发展战略与投资价值的高度认可。

（二）公司发展战略及2026年经营计划

我们的战略目标是逐步成长为国际领先的全互连芯片设计公司，重点聚焦于运力芯片领域，通过持续的研发创新，为用户提供丰富多样、具有组合竞争力的高速互连芯片解决方案，助力云计算和人工智能基础设施领域实现更高效与更稳定的数据互连。

展望2026年，公司的重点工作主要围绕以下几方面展开：

一是巩固内存互连领先优势，把握新产品渗透机遇。我们将持续推进DDR5 RCD芯片子代迭代，提升第三、第四子代产品出货规模；重点把握MRCD/MDB、CKD芯片等新产品的市场渗透机遇，进一步强化竞争优势。

二是拓展PCIe/CXL业务布局，驱动相关产品收入持续增长。我们将深化与云计算服务商、服务器OEM/ODM厂商以及GPU/CPU厂商的战略合作，加快新一代PCIe Retimer、CXL MXC芯片在更多客户供应链的导入；同时，我们将进一步加强市场拓展，推动相关产品收入持续增长。

三是深耕高速互连核心技术，不断丰富产品矩阵。在内存互连领域，我们将继续引领并投入内存接口技术的迭代与创新，巩固技术领先优势，计划完成DDR5第六子代RCD、第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发，同时积极参与JEDEC组织对DDR6内存接口芯片标准的制定，并启动DDR6 第一子代内存互连产品的工程研发。在PCIe/CXL互连领域，我们将加强高速SerDes等核心底层技术的研发投入，计划完成PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer、CXL 3.x MXC芯片量产版本的研发，并计划完成PCIe 7.0 Retimer、PCIe Switch芯片工程样片的流片。在以太网互连领域，我们将积极推进高速以太网PHY Retimer芯片的研发，并计划完成工程样片的流片。在时钟芯片领域，我们计划完成首批及第二批时钟缓冲芯片量产版本的研发。

四是强化人才体系建设，筑牢创新发展根基。公司港股上市后，我们将依托境内外双资本市场优势，进一步汇聚海内外优秀复合型人才，持续夯实核心人才竞争力。

最后，公司也将继续深化ESG管理，赋能可持续发展。

二、交流的主要问题及答复

问题1：公司如何看待此轮存储景气周期，AI Agent的快速发展对公司内存互连芯片有何影响？

答复：当前存储行业处于一个由AI驱动的“超级周期”，带动各类存储产品需求。作为一家内存互连芯片厂商，我们将受益于行业需求增长的产业趋势。

AI快速发展的背景下，算力爆发直接转化为对内存容量及带宽的更高要求，对内存互连芯片市场的影响，具体影响主要体现在以下两方面：

第一，内存模组用量增加，市场空间拓展。一台典型AI服务器配置的内存模组数量，通常是通用服务器的2倍左右，AI服务器渗透率的提升将为内存互连芯片市场带来广阔的增长空间。更关键的是，AI工作负载逐渐由训练向推理及应用端迁移，以AI Agent为代表的應用涉及大量逻辑判断、任务调度与实时交互，而CPU的通用计算架构非常适合这类工作任务。因此AI Agent的发展不仅直接拉动CPU的需求，也同步推动内存模组及其中内存互连芯片的需求。

第二，内存带宽成为瓶颈，技术迭代与升级加速。一方面，DDR5子代迭代明显提速。DDR5有六个子代，当前子代迭代周期已逐步缩短至12-18个月，技术迭代节奏较DDR4世代快。公司大致保持每年推出一子代产品的节奏，2025年下半年，我们的第三子代RCD芯片收入超过第二子代产品，第四子代RCD芯片也开始规模出货，我们继续保持行业领先地位。另一方面，高带宽内存模组MRDIMM以其带宽更高、综合性能更好的优势，逐步开始规模应用，产业趋势愈加明确。未来MRDIMM的起量会带动MRCD/MDB芯片需求同步上升。从2025年第四季度开始，我们的第二子代MRCD/MDB芯片出货量显著提升。

总结而言，AI从训练向推理迁移，以及Agent等新应用的爆发，对全球内存互连芯片市场扩容具有积极影响。我们凭借在DDR5子代迭代的领先优势，以及对MRCD/MDB等前沿技术的率先布局，将持续受益于这一产业趋势。

问题2：公司2025年年报中提到从2025年第四季度起第二子代MRCD/MDB芯片出货量显著提升，如何展望未来几年MRDIMM渗透率的趋势？

答复：关于MRDIMM的渗透率趋势，行业预期未来两到三年将从规模应用起步，进入快速爬升的关键周期，其核心驱动力来自AI工作负载（特别是推理场景）对内存带宽的迫切需求，以及产业生态的逐步成熟。

从技术性能看，第二子代MRDIMM的数据传输速率已达到12800MT/s，相比第一子代（8800MT/s）提升45%，是当前主流第三子代RDIMM（6400MT/s）速

率的两倍，能显著缓解AI推理等应用场景的内存带宽瓶颈，而第三子代MRDIMM支持速率将超过16000MT/s，实现性能的再次跃升。

从产业生态看，行业正在加速推进。将有更多的服务器CPU平台（包括部分基于ARM架构的平台）支持第二子代MRDIMM，这些CPU平台预计从2025下半年至2026年陆续发布。CPU平台的广泛支持，是MRDIMM得以在数据中心规模部署的基础，MRDIMM的生态将进一步完善。

从需求驱动看，AI推理相关应用（如AI Agent），有望为MRDIMM带来结构性、长期的需求。此类应用会产生巨大的KV Cache，对内存带宽提出极高的需求。MRDIMM的高带宽特性，能以更优的总体拥有成本（TCO）满足相关应用的需求。

以上因素将共同推动MRDIMM行业渗透率的提升以及MRCD/MDB芯片市场的增长。作为MDB芯片国际标准的牵头制定者，公司引领相关技术的创新并保持行业领先地位。2025年1月，我们推出了第二子代MRCD/MDB芯片，于第四季度实现出货量显著提升，我们的产品凭借优异的性能和出色的稳定性获得全球主要内存模组厂商的认可，为后续产业放量奠定了基础。公司计划今年完成第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发，以持续巩固技术领先地位。

问题3：请问CKD芯片去年的出货情况怎样，今年及未来的渗透率趋势如何？

答复：

根据JEDEC定义，当DDR5数据速率达到6400MT/s及以上时，PC端内存模组需采用一颗专用的CKD芯片对时钟信号进行缓冲和重新驱动，以满足高速时钟信号的完整性和可靠性要求。CKD芯片从2024年起进入行业规模试用，在2025年渗透率进一步提升，我们的产品出货量也实现了快速增长。

由于AI PC需要更高内存带宽以提升整体运算性能，因此，AI PC的普及将加速DDR5向更高速率发展，从而推动CKD芯片的需求。CKD芯片有望在未来三至四年内逐步完成主流渗透。

作为CKD芯片国际标准的牵头制定者，我们继2024年在业界率先试产DDR5 CKD芯片（支持速率为7200MT/s）之后，于2025年推出新一代CKD芯片，支持速率高达9200MT/s，可为下一代高性能PC提供关键技术支撑。随着DDR5速率提升和AI PC生态成熟，我们将持续受益于这一增量市场。

问题4：公司2025年研发费用大幅增长的原因是什么？如何看待2026年研发费用

的趋势？

答复：公司的研发费用主要由于研发技术人员薪酬、工程开发费用、相关工具及许可证费用等构成。2025年公司研发费用为9.15亿元，同比增长近20%，主要因为：一是研发团队规模扩大，研发技术人员薪酬有所增长；二是多款在研产品在2025年取得积极进展，推动了相关工程开发费用的增加。

公司自2019年上市以来，研发费用连续六年保持增长。展望未来，随着公司业务规模的扩大和在研项目的持续推进，研发费用预计将保持合理增长。公司会依据不同项目的技术阶段、市场前景与风险，对研发资源进行合理配置。

问题5：针对DDR5，公司已经在研最后一个子代RCD芯片，请问DDR6相关互连产品的行业标准制定和研发进度如何？

答复：根据JEDEC公布的信息，DDR5内存接口芯片已经规划了六个子代产品，公司目前正在进行第六子代RCD芯片的研发，并计划在2026年完成工程研发。

JEDEC组织正持续对DDR6内存互连技术以及产品标准进行讨论，主流趋势是：DDR6内存模组将配置数量更多、设计更复杂的内存互连芯片。公司正深度参与相关技术标准的讨论和制定，计划在今年正式启动DDR6第一子代内存互连芯片的研发，以使得我们在下一代技术浪潮中继续保持行业领先地位。

问题6：公司PCIe 6.0 Retimer及PCIe Switch 芯片目前的进展情况是什么？公司PCIe业务技术优势及竞争壁垒有哪些，未来的市场份额的预期如何？

答复：目前，公司PCIe Retimer芯片的出货以Gen 5产品为主。2025年1月，我们推出PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片并向客户送样，目前正积极配合客户测试验证。由于支持PCIe 6.0的服务器CPU尚未进入规模量产阶段，相关Retimer芯片仍处于产业导入期，公司当前的进度符合预期。我们于今年1月还发布了PCIe 6.x/CXL 3.x 的AEC解决方案。同时，我们正在积极推进PCIe 7.0 Retimer芯片的研发，计划今年完成工程样片的流片。

PCIe Switch芯片是公司拓展PCIe互连市场的关键产品，目前研发工作正常推进，公司计划在今年完成工程样片的流片。

在PCIe互连领域，高技术和商业门槛共同构成竞争壁垒。技术层面，该领域门槛高，需要长期技术积累，并能够保持持续迭代能力。我们先后成功量产PCIe 4.0和5.0 Retimer芯片，并持续投入PCIe 6.0和7.0 Retimer芯片的研发，形成了深厚的技术积累。我们的核心优势在于自研的SerDes技术，这使得公司产品在时延、

信道适应能力等关键性能上具备竞争力，并获得了客户的积极反馈。商业与生态层面，客户倾向于选择能提供性能优异、质量稳定可靠并能持续迭代产品的供应商，通过与客户在PCIe 4.0、5.0及6.0 Retimer芯片上的合作，我们积累了深厚的客户验证经验以及成熟的产品化能力，并与产业链构建了良好的协作关系，获得了客户的广泛认可。基于共通的SerDes技术基础以及类似的客户及商业生态，公司布局PCIe Switch芯片具有一定的优势。

根据行业分析，PCIe互连芯片未来市场规模将持续高速增长，弗若斯特沙利文预计2030年市场规模将达到77.61亿美元（包括PCIe Retimer和PCIe Switch芯片），2025至2030年间的年复合增长率高达20.1%。我们认为，未来市场份额的获取将取决于扎实的技术储备、可靠的产品交付以及准确把握市场导入时机的能力。对公司而言，重要的是持续做好产品的研发和技术迭代。随着PCIe Retimer芯片的不断升级，以及未来PCIe Switch芯片的推出，我们希望凭借核心技术优势及逐步完善的产品组合，在未来的市场竞争中持续提升市场份额。

问题7：为什么公司会考虑自研SerDes技术去做Retimer芯片，SerDes技术在公司产品布局的角色，公司未来在该项技术的迭代计划是怎样的？

答复：SerDes是高速互连领域的重要基础技术，作为多种重要高速传输技术（如PCIe、USB、以太网等）的物理层基础，广泛应用于服务器、异构计算、汽车电子和通信等领域的高速互连。目前高性能SerDes技术主要集中于少数海外厂商。

自研高速SerDes IP是公司在技术层面的战略决策，是一件“难而正确”的事，既支撑着我们当前产品的市场竞争力，也构筑了未来拓展更广阔领域的技术基石。一方面，高速SerDes技术是公司PCIe/CXL互连、以太网及光互连领域相关产品的共同核心底层技术，可实现多个产品技术复用，有助于未来延展至更多领域，并可避免外购IP的相关限制；另一方面，自主研发使我们掌握底层架构，具备更高的设计灵活性和深度优化能力，从而提升产品差异化与竞争力，我们的PCIe 5.0 Retimer芯片中正是凭借自研SerDes IP，在时延、信道适应能力等方面表现优异。

近年来，我们持续投入高速SerDes技术的研发并不断取得新突破，已成功研发支持32GT/s的SerDes IP用于PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片，在此基础上，我们进一步攻克了难度更大的64GT/s的SerDes IP，应用于PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer产品。未来，我们将继续推进SerDes技术的迭代升级，目前在研的PCIe 7.0 SerDes IP支持128GT/s，并已启动以太网SerDes IP的研发工作。

问题8：公司2025年互连类芯片毛利率水平较2024年进一步增长，特别是第四季度超过了67%，公司如何预计今年及未来毛利率水平的情况？

答复：2025年，公司整体毛利率为62.2%，互连类芯片产品线毛利率为65.6%，其中第四季度互连类芯片毛利率为67.8%，较第三季度提升2.1个百分点。

公司互连类芯片的产品品类越来越多，同一品类产品也在持续升级迭代，互连类芯片毛利率更多体现了多款产品的综合毛利率水平，与公司当期销售的产品结构相关。展望未来，通过持续的子代迭代和高端新产品的推出，互连类芯片毛利率有望保持在较高水平。

问题9：国内外服务厂商都在推动CXL架构，公司是否看到这样的趋势？预计行业CXL生态什么时候开始起量？公司在CXL领域相较其他竞争对手有哪些优势？

答复：当前，产业界正积极推进CXL技术的落地与商业化。例如，某头部云厂商推出了基于CXL的数据库专用服务器；某头部服务器厂商也发布了集成CXL内存扩展方案的服务器产品。其核心驱动力，是AI推理等场景对海量、低延迟内存的迫切需求，通过CXL技术进行分层存储与池化，可有效解决AI发展面临的“内存墙”问题，进而大幅降低系统总拥有成本（TCO）。

行业分析认为，今年是CXL规模化部署的起点。预计从明年开始，随着支持CXL 3.0的服务器CPU平台量产，更先进的内存池化方案将逐步落地，未来几年CXL在数据中心的渗透率有望进入快速提升阶段。

公司在CXL互连领域的竞争优势，主要体现在以下几方面：

一是技术先发和持续领先优势。公司于2022年全球首发CXL MXC芯片；2025年9月，公司推出CXL 3.1 MXC芯片，并已向主要客户送样测试，进一步巩固在该领域的技术领先地位。

二是深厚的客户与生态壁垒。近年来，公司与合作伙伴共同推进CXL技术的商用化进程，目前已有多家服务器厂商、云厂商推出基于澜起MXC芯片的内存扩展和内存池化方案。我们与客户从研发初期就开始深度合作，形成了稳固的客户基础和生态优势。

三是更完整的解决方案能力。除了MXC芯片，我们还提供PCIe/CXL Retimer芯片，用于保障高速信号完整性，为客户提供从内存控制到高速互连的一站式解决方案，增强了我们的整体市场竞争力。

展望未来，随着CXL生态的逐步成熟和技术的广泛普及，MXC芯片市场将

迎来广阔的发展空间，公司有望持续受益于这一产业趋势。

问题10：公司如何规划在以太网和光互连领域的布局？

答复：以太网及光互连是高速互连领域的重要环节，具有广阔的成长空间，也是澜起战略布局的重要方向。我们将充分借助在内存互连及PCIe/CXL互连领域长期积累的技术和资源储备，积极探索适合我们战略布局的新市场，灵活运用自研、合作及投资等多种方式，循序渐进、稳步推进我们在以太网及光互连领域的产品布局。

目前，我们正积极推进高速以太网PHY Retimer芯片的研发，计划于今年完成工程样片的流片。未来，我们也会根据市场需求及自身的技术积累，在该领域布局更多有潜力的产品。

问题11：目前内存缺货严重，公司是否面临供应链端成本上升或者交期延后的影响？

答复：由于上游部分材料结构性供应紧张，目前我们所处的产业链交期普遍变长。公司已搭建了成熟可靠的全球供应链体系，我们根据行业供需情况，合理地进行产能筹划。目前公司相关产品的产能供给总体稳定，基本能够满足订单需求。

问题12：公司H股上市后有哪些计划和新机会？

答复：公司成功在H股上市，构建起“A+H”双资本平台，为我们带来了多维度的发展机遇。

首先，H股上市有助于我们进一步吸引国际顶尖人才，深化全球业务布局，并提升品牌的国际影响力；其次，募集资金将为公司核心技术迭代提供有力支撑，覆盖内存互连、PCIe/CXL互连以及底层SerDes技术等方向，并支持我们向以太网及光互连等更广阔的市场进行拓展；再次，部分募集资金将用于战略投资或收购，帮助公司快速获取新技术、进入新市场或整合产业链资源，从而构建更完整的产品与解决方案体系。同时，登陆国际资本市场也让更多海外投资人有机会进一步认识和投资澜起，有利于优化公司的估值体系。

我们将以H股上市为契机，借助国际资本市场的力量，加速技术优势的巩固与全球业务拓展，把握人工智能时代的历史性机遇。

是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无